公司代號:2332

序號:1

主旨: 代子公司D-Link JAPAN K.K Ltd(簡稱DJP)公告資金貸與相關事宜

符合條款-第四條第XX款:23

1.事實發生日:115/11/17

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:友訊科技股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

D-Link JAPAN K.K. Ltd.為本公司(友訊科技)直接持有100%之海外子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):647,268

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):372,410

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):372,410

(8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容: 無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):6,021,632

(2)累積盈虧金額(仟元):2,582,945

5.計息方式: 依合約規定

6.還款之:

(1)條件: 依合約規定

(2)日期: 依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 1,777,500

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

21.53%

9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身

10.其他應敘明事項: 無